



受講料無料 3時間コース

令和4年度 半導体基礎講座

IoT、AI 活用が進展する中、ロボット、車、スマホと身近で利用されている半導体について、半導体産業の概要や製造工程の基礎知識を学ぶ

内容

半導体産業の概要、および半導体製品の開発から製造、テストにいたるまでの工程概要と要素技術

Web 配信

① 2022年6月16日(木) 13:30~16:30

② 2022年6月23日(木) 13:30~16:30

③ 2022年6月30日(木) 13:30~16:30

※1. 申込期限 2022年6月9日(木)

※2. 1回のみでの参加も可能です。

本年度は「ZOOM」を使用したweb配信のみとさせていただきます。
参加案内(URL)は後日申込者へメールでご連絡いたします。

講師

大森 雅登氏 (大分大学 理工学部 准教授)

筒井 信明氏 (半導体人材育成教育コンサルタント)

受講対象者

LSI クラスター会員企業の方(技術・事務を問いません)、
または会員企業に就職予定の方

講座のねらい・特徴

半導体産業・動向から半導体製造工程やテストについての基礎知識・要素プロセス技術を短期間に学べる。

半導体産業・製造の基礎知識を学ぶことにより、今後従事する、または従事している職務のレベルアップや改善が図れる。

当講座は「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」を利用している
もしくは利用予定の事業所が外部委託訓練として利用できる講座です。
(制度の詳細は、最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい)

主催:



大分県 LSI クラスター形成推進会議

<http://www.oita-lsi.jp/>

令和4年度 半導体基礎講座（3時間コース）

半導体基礎講座① 6月16日（木） 講師：大森 雅登氏		
半導体の基礎知識 （半導体について）	半導体の歴史	トランジスタの発明から LSI へ 半導体市場
	半導体デバイスの基礎	半導体材料とバンド構造
		ダイオード・トランジスタの動作原理
		様々な半導体デバイス

半導体基礎講座② 6月23日（木） 講師：筒井 信明氏		
半導体開発・製造工程概論 （ウェハー製造）	LSI 開発・製造の流れ	LSI 開発・製造の全体フロー
	LSI の開発・設計	LSI 開発の流れ
		設計
		フォトマスク
	シリコンウェハー	シリコンウェハーの製造
		シリコンウェハー口径と平坦性の推移
	ウェハー処理工程	ウェハープロセス
		リソグラフィ工程
		エッチング工程
		洗浄工程
		イオン注入工程
		熱処理・成膜工程
配線および電極形成工程		

半導体基礎講座③ 6月30日（木） 講師：筒井 信明氏		
半導体製造工程概論 （組み立て、テスト）	LSI 開発・製造の流れ	LSI 開発・製造の全体フロー
	組み立て工程	実装技術
		パッケージタイプの変遷
		パッケージング
	半導体評価・テスト・解析	評価・テスト・解析の役割
		評価
		テスト
		解析

参加申込規定

- 申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail または FAX でお送りください。

ご注意

- 出席者を確認しますので、ZOOM では名前表示をフルネーム（漢字・ローマ字）集団受講の方は会社名にしてご参加ください。
- 録音、撮影（スクリーンショット）はご遠慮ください。
- テキストは各社の申込代表者に電子ファイルで送付いたします。
代表者は受講者に配布をお願いいたします。
（※1）開示は各社内のみとしてください。
（※2）著作権法に基づき、本書の全てまたは一部を複製・複製・転載する事を一切禁止します。
- 受講証明書は希望者のみ発行いたしますので、必要な方は参加申込書に必要事項を記入の上お申し込みください。

【お問い合わせ＆お申込先】

FAX : (0977) 72-9968 / E-mail : hr-develop-biz@elia-jp.com

〒879-1507 大分県速見郡日出町大字豊岡字岩垣 799 番地 1

(株)エリア 日カノ小石 ☎0977-73-2485